

檔 號：

保存年限：

## 財團法人國家實驗研究院 函

地址：300091新竹市科學園區展業一路  
26號

聯絡人：羅愛雁

電話：03-5773693分機7769

電子信箱：0508364@niar.org.tw

受文者：國立中央大學研發處

發文日期：中華民國114年10月21日

發文字號：國研授半導體企字第1141301549 號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一JRC2026徵案重點說明、附件二JRC2026徵求公告attch1 attch2

主旨：本院台灣半導體研究中心「115年台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心（TSRI-CTU Joint Research Center）徵案計畫」，自公告日起至11月21日受理申請，請惠予轉知貴校半導體相關科系研究團隊踴躍申請，請查照。

說明：

- 一、為促進台捷雙方合作交流，國家實驗研究院台灣半導體研究中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU)自2025年起成立聯合研究中心並推動雙邊研究合作計畫，迄今已展現良好成效。為延續合作基礎並深化雙方交流，今年決議續辦並徵求2026年度的雙邊研究合作計畫。
- 二、本計畫之執行期程自115年1月1日至115年11月20日。
- 三、有關申請資格、補助經費、申請方式、審查標準、重要時程及其他注意事項等，請詳附件重點說明及徵求公告，或參考本院台灣半導體研究中心官網之最新消息：  
[https://www.tsri.org.tw/tw/infoopen/infoOpenCommon\\_detail.jsp?newsId=2025101503&kindName=Activities](https://www.tsri.org.tw/tw/infoopen/infoOpenCommon_detail.jsp?newsId=2025101503&kindName=Activities)，申請機構及計畫主持人務必先行詳閱各項規定。
- 四、相關計畫內容疑問，請洽：03-5773693 #7779(葉先生) #7170(江小姐)

正本：大同大學研發處、大葉大學研發處、中原大學研發處、中國文化大學研發處、中華大學學校財團法人中華大學研發處、中華學校財團法人中華科技大學研發處、元智大學研發處、玄奘大學研發處、明志科技大學研發處、明新學校財團法人明新科技大學研發處、東吳大學研發處、東海大學研發處、長庚大學研發處、南臺學校財團法人南臺科技大學研發處、城市學校財團法人臺北城市科技

大學研發處、國立中山大學研發處、國立中央大學研發處、國立中正大學研發處、國立中興大學研發處、國立成功大學研發處、國立東華大學研發處、國立虎尾科技大學研發處、國立金門大學研發處、國立屏東科技大學研發處、國立政治大學研發處、國立高雄大學研發處、國立高雄科技大學研發處、國立高雄師範大學研發處、國立清華大學研發處、國立陽明交通大學研發處、國立雲林科技大學研發處、國立勤益科技大學研發處、國立嘉義大學研發處、國立彰化師範大學研發處、國立暨南國際大學研發處、國立臺中科技大學研發處、國立臺中教育大學研發處、國立臺北大學研發處、國立臺北科技大學研發處、國立臺北教育大學研發處、國立臺南大學研發處、國立臺灣大學研發處、國立臺灣科技大學研發處、國立臺灣師範大學研發處、國立臺灣海洋大學研發處、國立聯合大學研發處、國防大學研發處、崑山科技大學研發處、淡江大學學校財團法人淡江大學研發處、逢甲大學研發處、義守大學研發處、臺北市立大學研發處、輔仁大學學校財團法人輔仁大學研發處、靜宜大學研發處、龍華科技大學研發處

副校長：蔡宏營

## 台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心 (TSRI-CTU Joint Research Center) 徵案計畫

2025.10

本中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學 (Czech Technical University in Prague, CTU) 自2025年起成立聯合研究中心並推動雙邊研究合作計畫，迄今已展現良好成效。為延續合作基礎並深化雙方交流，今年決議續辦並徵求2026年度的雙邊研究合作計畫。

本徵案計畫旨在透過學術合作與本中心服務平台，建立團隊間長期穩定的夥伴關係，並促進雙邊科研資源與優勢共享。本案以台方計畫主持人為申請者，依本中心公布辦法與相關文件進行研究計畫案申請，其餘說明如下：

一、計畫收件時間：自公告日起至2025年11月21日(五)23:59(GMT+8)

二、計畫期程：因配合雙方內部作業流程，將於2025年12月19日確認審查獲選名單，入選團隊將會進行限制性招標，計畫期程自決標日起，於2026年7月3日前繳交期中查驗報告，並於2026年11月20日前繳交期末驗收報告，計畫截止日為2026年11月20日。

三、徵案條件：

### 1. 執行對象：

徵案團隊須為台方大專院校與CTU教授之共同合作組成，雙邊共同執行同一計畫主題，並由台方計畫主持人為申請者，在期限內提交研究計畫申請書，以進行後續評選。

### 2. 研究主題領域：

- 1) 晶片設計領域：Analog Design, Digital Design, MEMS Sensors, Silicon Photonics\_及其他設計領域相關主題
- 2) 晶片製造領域：Semiconductor Manufacturing Technology, Technology Computer-Aided Design (TCAD) 及其他製造領域相關主題
- 3) 請有意參與研究的團隊進入下方連結進行研究主題與聯絡資訊的填寫，以利雙邊團隊媒合：[Matching List](#)
- 4) 請有意參與研究的團隊進入下方連結上傳研究領域介紹投影片檔案，以利雙邊團隊媒合：[Matching Folder](#)

3. 對於入選的徵案團隊，雙邊團隊之間可能需要簽訂協議，例如 CRA (Collaborative Research Agreement)。該協議可能明訂雙方權利義務分配等項目，包括有關智慧財產權的條款，協議內容將由雙邊研究團隊自行商定。

4. 依據政府採購法利益迴避原則，計畫申請人應避免擔任此計畫之評審委員。

#### 四、計畫補助：

1. 每件計畫補助研究經費最高新臺幣壹佰玖拾萬元，將以分批付款方式給付，確認獲選後付款50%，通過期中查驗付款40%，最終通過期末結案驗收付款10%。
2. 依計畫申請書之晶片下線需求規劃（如有），TSRI將配合研究計畫實際執行進度補助每案最高新台幣貳佰萬元整之TSRI晶片下線額度，以支持研究團隊進行晶片實作發表。

#### 五、申請方式與時間：

請備齊雙邊共同以英文撰寫之研究計畫申請書(附件一，Word 檔)及相關補充資料，於收件截止日期(台灣時間2025年11月21日23:59)前寄送至 [tsri.ctu\\_jrc@nlar.org.tw](mailto:tsri.ctu_jrc@nlar.org.tw)，將以信件寄出時間為憑，逾期概不受理。計畫申請書於送件後即不得修改及增訂，評審完畢後亦不予退回。

六、評定辦法：符合徵案資格且在期限內提供申請文件者，將依照雙邊連結性(30%)、實現可行性(25%)、技術前瞻創新性(20%)、延伸合作潛力(15%)及預算規畫合理性(10%)等項目進行計畫內容及預算的評比，評選結果將於12月19日通知獲選團隊。如未通過審查，原計畫書文件將不會退還申請人。

#### 七、計畫期程與查驗時間點：

計畫執行期間為限制性招標決標後起始，至2026年11月20日為計畫截止日。此計劃共包含兩次查驗，分為期中查驗及期末結案驗收。

1. 期中查核點：於2026年7月3日前提交期中進度執行報告書及計畫時程進度檢核表，期中進度執行報告書內容應包含目前實際執行計畫內容、已完成之工作項目及未完成事項之期程等，並至少完成1項執行績效量化指標。
2. 期末結案查核：於2026年11月20日前完成研究計畫書內之規劃項目並提交期末結案報告書及計畫時程進度檢核表，期末結案報告內容包含雙邊研究報告說明、雙邊短期交流紀錄與心得、學術論文或專利申請證明等執行績效成果說明。

#### 八、注意事項：

##### 1. 研究計畫申請書的結構如下：

- 1) 基本資料（計畫主題與分類、雙邊團隊主持人及聯繫窗口資訊）
- 2) 團隊成員（雙邊團隊協作人員學歷、職掌與分工）
- 3) 計畫摘要
- 4) 計畫內容（計畫背景、技術優勢、研究實施策略、預期成果及國際研究合作之價值貢獻等）
- 5) 計畫時程規劃（工作時程控管、查核點說明、預計完成項目及績效項目說明）
- 6) 預算規劃
- 7) 雙邊聲明與簽名
- 8) 附件

2. 此計畫研究經費的使用需建立清冊，可提供期末結案查核時備查。

3. 重要作業時程：

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 開放申請   | 2025年10月15日(三)<br>(若公告日晚於10月15日，則以公告日為申請起始日) |
| 申請截止日期 | 2025年11月21日(五)                               |
| 公告獲選名單 | 2025年12月19日(五)                               |
| 計畫起始日  | 2026年1月1日(四)<br>(若決標日晚於1月1日，則以決標日為計畫起始日)     |
| 期中查驗   | 2026年7月3日前提提供查驗報告                            |
| 期末驗收   | 2026年11月20日前提提供結案報告                          |

**九、聯繫窗口：**

聯絡電話：03-5773693 #7779(葉先生) #7170(江小姐)

E-mail：[tsri.ctu\\_jrc@niar.org.tw](mailto:tsri.ctu_jrc@niar.org.tw)

## 「115 年台灣半導體研究中心與布拉格捷克理工大學聯合研究中心 (TSRI-CTU Joint Research Center) 徵案計畫」重點說明

台灣半導體研究中心(TSRI)與布拉格捷克理工大學(Czech Technical University in Prague, CTU) 自 2025 年起成立聯合研究中心並推動雙邊研究合作計畫，迄今已展現良好成效。為延續合作基礎並深化雙方交流，今年決議續辦並徵求 2026 年度的雙邊研究合作計畫，透過學術合作與 TSRI 之服務平台，建立團隊間長期穩定的夥伴關係，尋求雙邊科研資源與優勢共享。

### (一) 執行期程：

配合台捷雙方內部作業流程，將於 2025 年 12 月 19 日確認審查獲選名單，入選團隊將會進行限制性招標，計畫期程自決標日起，於 2026 年 7 月 3 日前繳交期中查驗報告，並於 2026 年 11 月 20 日前繳交期末驗收報告，計畫截止日為 2026 年 11 月 20 日。

### (二) 執行對象：

徵案團隊須為台方教授與 CTU 教授之共同合作組成，雙邊共同執行同一計畫主題，並由台方計畫主持人為申請者，在期限內提交研究計畫申請書，以進行後續評選。

### (三)補助計畫內容：

1. 每件計畫補助研究經費為新臺幣壹佰玖拾萬元，將以分批付款方式給付，確認獲選後付款 50%，通過期中報告查驗付款 40%，最終通過期末結案報告驗收付款 10%。
2. 依計畫申請書之晶片下線需求規劃（如有），TSRI 將配合研究計畫實際執行進度補助每案最高新台幣貳佰萬元整之 TSRI 晶片下線額度，以支持研究團隊進行晶片實作發表。

### (四)申請方式及時間：

請備齊雙邊共同以英文撰寫之研究計畫申請書(附件一，Word 檔)及相關補充資料，於收件截止日期(台灣時間 2025 年 11 月 21 日 23:59)前寄送至 [tsri.ctu\\_jrc@niar.org.tw](mailto:tsri.ctu_jrc@niar.org.tw)，將以信件寄出時間為憑，逾期概不受理。計畫申請書於送件後即不得修改及增訂，評審完畢後亦不予退回。

### (五)審查評分標準：

符合徵案資格且在期限內提供申請文件者，將依照雙邊連結性(30%)、實現可行性(25%)、技術前瞻創新性(20%)、延伸合作潛力(15%)及預算規畫合理性(10%)項目進行評比。評選結果將於 12 月 19 日通知獲選團隊。如未通過審

查，原計畫書文件將不會退還申請人並不接受申覆。

(六) 重要作業時程：

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 開放申請   | 2025 年 10 月 15 日(三)<br>(若公告日晚於 10 月 15 日，則以公告日為申請起始日) |
| 申請截止日期 | 2025 年 11 月 21 日(五)                                   |
| 公告獲選名單 | 2025 年 12 月 19 日(五)                                   |
| 計畫起始日  | 2026 年 1 月 1 日(四)<br>(若決標日晚於 1 月 1 日，則以決標日為計畫起始日)     |
| 期中查驗   | 2026 年 7 月 3 日前提供查驗報告                                 |
| 期末驗收   | 2026 年 11 月 20 日前提供結案報告                               |